

# INFICON石英晶片

## 优化过程效率和耗材库存

INFICON石英晶片能够最大限度地减少过程中断并降低耗材成本。每片晶片都经过测试和检验，以确保最一致、最可靠的晶片质量以及最长晶片寿命。通过灵活的交货计划，INFICON将与您一起优化库存管理。作为薄膜解决方案领域的全球领军者，我们将稳定供应关键组件。

## 交付您所需的晶片

INFICON可提供具有不同晶片直径、频率、电极图案、电极镀层和包装选项的真空沉积晶片，以满足每位客户的独特需求。此外，INFICON还生产应用特定专用晶片，例如ALD沉积定制晶片。有关晶片的所有变体及其用途的更多信息，请参阅应用说明“INFICON石英监测晶片指南”，请访问网站：<https://goo.gl/UEHuXY>

## 选择适当的晶片

我们对石英晶片特性的不断研究实现了持续改进，可为您的过程确保最高可靠性。对于大多数应用，建议使用金电极晶片。然而，在溅射等热负荷较高的过程中，银电极晶片将发挥出色的性能。它们还可以改善氧化物的沉积。对于使用介电材料的光学镀膜以及使用高应力材料的半导体过程，建议使用合金电极晶片。

## 高温晶片

INFICON的高温石英晶片专为ALD和无法进行水冷的其他应用而设计，在持续高温下可为您提供出色的性能和频率稳定性。可提供针对各种温度经过优化的高温晶片。



## 规格齐全的薄膜控制仪

无论您的系统简单还是复杂——无论它涉及到热蒸发、溅射还是离子束过程——规格齐全的INFICON控制仪、监测仪、传感器和馈入件都能满足您的需求，从而优化沉积过程并使您能够生产优质的产品。

## 优势

- 通过最一致、最可靠的晶片最大限度地降低耗材成本
- 通过更长的生产时间提高盈利能力并最大限度地实现连续过程运行
- 通过灵活的交货计划和库存产品优化库存管理
- 由通过ISO认证的企业稳定供货
- 通过遍布全球的应用支持网络最大限度地提高过程性能并获得定制解决方案
- 在专家的支持下快速排除过程差异

## INFICON石英晶片 (续)

### 4种方便的包装

- 洁净室兼容型分片器 —— 包含10片晶片，可使用Teflon®镊子或使用提供的工具直接分发到传感器座中。
- 扁平封装转盘式分片器 —— 包含10片晶片，可使用真空笔、Teflon镊子提取，或直接分发到传感器座中。扁平封装转盘式包装易于储存和堆放。
- 紧凑型包装盒 —— 包含10片INFICON晶片，便于储存，占用最少的货架空间。可使用塑料镊子或真空笔分发晶片。晶片由惰性低摩擦纸相互分开，并由泡沫垫提供缓冲。
- 50片装包装 —— 一个透明的矩形塑料包装中包含50片INFICON晶片。这种包装可为大量生产提供便利。50片装包装易于储存和堆放。可使用真空笔分发晶片。

### 全部经过测试和检验

INFICON在洁净室中制造并检验每片晶片，可为从石英原料到准备装运的最终包装产品的整个过程提供最高标准的质量保证，所用标准如下：

- 电阻：检验以确保测量稳定性和更长的镀层寿命
- 曲率：检验以确保谐振稳定性
- 频率：在安装电极前后检验以确保精确的厚度测量
- 外观一致性：检验电极均匀性、是否存在表面缺陷以及其他可能指示附着力差或污染的缺陷
- 外观一致性 —— 检验每片晶片的电极均匀性、是否存在表面缺陷以及其他指示电极附着力差和污染的缺陷。

## INFICON石英晶片 (续)

## 订购资料

零件号	描述 (除非另有说明, 否则, 晶片直径为14毫米 (0.55英寸), 每包10片晶片)
008-010-G10	6兆赫兹, 金电极, 装在洁净室兼容型分片器中
008-009-G10	6兆赫兹, 银电极, 装在洁净室兼容型分片器中
750-679-G1	6兆赫兹, 合金电极, 装在洁净室兼容型分片器中
SPC-1157-G10	6兆赫兹, 金电极, 抗热冲击, 装在洁净室兼容型分片器中
750-1000-G10	6兆赫兹, 金电极, 装在扁平封装转盘式分片器中
750-1001-G10	6兆赫兹, 银电极, 装在扁平封装转盘式分片器中
750-1002-G10	6兆赫兹, 合金电极, 装在扁平封装转盘式分片器中
SPC-1194-G10	6兆赫兹, 金电极, 抗热冲击, 装在扁平封装转盘式分片器中
SPC-1093-G10	6兆赫兹, 金电极, 装在紧凑型包装盒中
750-1014-G10	6兆赫兹, 银电极, 装在紧凑型包装盒中
750-1015-G10	6兆赫兹, 合金电极, 装在紧凑型包装盒中
750-225-G2	5兆赫兹, 金电极, 装在洁净室兼容型分片器中
750-226-G2	5兆赫兹, 银电极, 装在洁净室兼容型分片器中
750-678-G1	5兆赫兹, 合金电极, 装在洁净室兼容型分片器中
750-1005-G10	5兆赫兹, 金电极, 装在扁平封装转盘式分片器中
750-1006-G10	5兆赫兹, 银电极, 装在扁平封装转盘式分片器中
750-1007-G10	5兆赫兹, 合金电极, 装在扁平封装转盘式分片器中
750-1016-G10	5兆赫兹, 金电极, 装在紧凑型包装盒中
750-1017-G10	5兆赫兹, 银电极, 装在紧凑型包装盒中
750-1018-G10	5兆赫兹, 合金电极, 装在紧凑型包装盒中
750-1020-G10	5兆赫兹, 金电极, 直径12.4毫米 (0.490英寸), 装在洁净室兼容型分片器中
高温晶片	
750-1058-G10	120摄氏度优化晶片, 6兆赫兹, 14毫米 (0.55英寸), 金电极, 10片装
750-1059-G10	240摄氏度优化晶片, 6兆赫兹, 14毫米 (0.55英寸), 金电极, 10片装
750-1060-G10	285摄氏度优化晶片, 6兆赫兹, 14毫米 (0.55英寸), 金电极, 10片装